

产品概要

半导体封装用气密密封剂

这是能够应对低透湿、减少扭曲、低脱气等要求的高可靠性气密密封剂,应对小型~大型的

陶瓷以及塑料封装,还能够应对高温回流工艺

特征

产品名称	5910	5920
主成分	环氧	环氧
硬化条件	6,000mJ/c m ² +120°Cx30min	6,000mJ/c m ² +120°Cx30min
粘度(mPa·s)	33,000	31,000
透湿度(g/m ² -24h)	5.0	5.3

产品名称	8723K9B
主成分	环氧
硬化条件	6,000mJ/c m ² +120°Cx30min
粘度(mPa·s)	37,000
透湿度(g/m ² -24h)	6.5